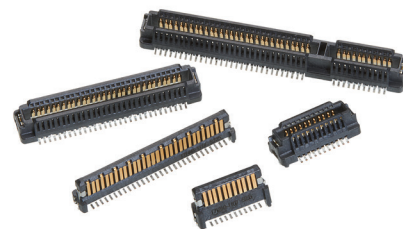


# SpeedMezz コネクターファミリー

molex®

SpeedMezz コネクターファミリーは、高密度、低背、ディファレンシャルペアあたり最大データ転送速度56 Gbpsの性能と、リセプタクルのフットプリント共通化によるアップグレードが容易な特徴を備え、高速メザニンカードや堅牢エッジカード、さらに低速アプリケーション等、多様なソリューションに対応する製品です。

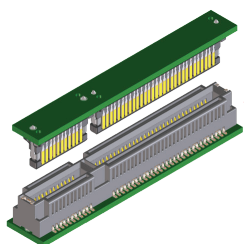


SpeedMezz コネクターファミリー

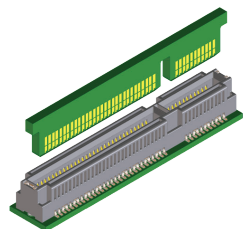
## 特徴・利点

**SpeedEdge: データ転送速度40 Gbps (56 Gbps対応品開発予定)**

ネットワーキング、電気通信、医療機器アプリケーションに最適



SpeedEdge メザニンコネクター



SpeedEdge エッジカードコネクター

**SpeedEdge: リセプタクルの急峻なリードイン部を延長**

エッジカードへの嵌合性能を向上

**ピンインペースト半田ネール付き、SMT半田テール**

プレスフィット嵌合構造と堅牢アタッチメントを使用し、優れたシグナルインテグリティを確保

**極数: 22、60、82極から選択可能**

ピン数選択可能、高密度信号向けソリューションを提供

**SpeedStackリセプタクルのフットプリントをSpeedEdgeと共有化**

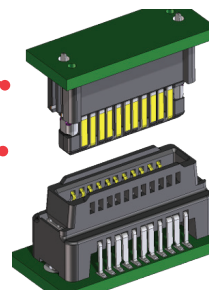
低背メザニン接続でドロップイン交換が可能

**エッジカード保持力**

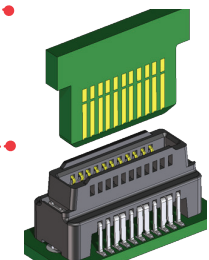
エッジカードの嵌合状態を確実に保持し、システム設計者に接続方法の選択肢を提供

**SpeedStack: 最大データ転送速度56 Gbps**

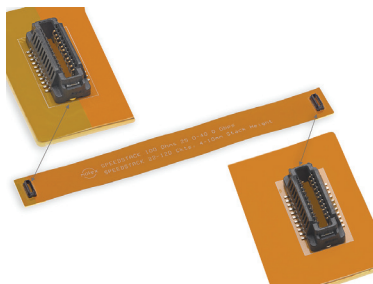
ネットワーキング、電気通信、医療機器アプリケーションに最適



SpeedStack メザニンコネクター



SpeedStack エッジカードコネクター



**SpeedFlexおよびSpeedCableアセンブリー**

SpeedFlexアセンブリー特徴:

低背が要求されるスタック高さと複雑設計に対応。

SpeedCableアセンブリー特徴:

長距離間の接続向けの完全なソリューション。

**共通接地ピンを廃止**

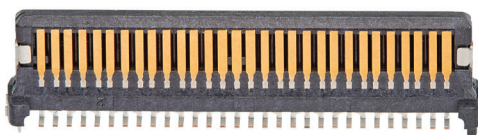
低速 / 低電流要件向けに追加ピン用エリアを確保

**速度: ディファレンシャルペア最大20 Gbps**

ネットワーキング、電気通信、医療機器アプリケーションに最適

**SpeedFieldコネクターのフットプリントとSpeedStackおよびSpeedEdgeプラグのフットプリントに互換性**

コネクター製品ラインの変更時に基板の再設計が不要なため、設計の柔軟性が実現



SpeedField プラグ

**シングルエンド、ハーフウェハー使用可**

1個のコネクターで電源と信号を伝送。例: 60極を、高速データ転送用の高速差動ペア (8ペア = 28極 + 4極スペア = 2極) とシングルエンド (30極、全スペア) の電源線に分割。

## アプリケーション

### 通信 /

#### ネットワーク関連機器

サーバー  
ルーター  
スイッチ  
ストレージ  
リモートアンテナ  
基地局  
携帯電話

### 防衛

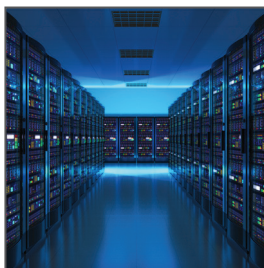
スキャン装置

### 医療機器

画像診断  
画像保存通信システム (PACS)

### コンシューマー

カメラ  
ハンドヘルドスキャナー



ハイエンドサーバー



基地局



医療機器

## 仕様

### 参考情報

梱包形態: エンボステッピング  
UL申請No.: 未定  
嵌合相手: SpeedMezz嵌合プラグ / リセプタクル  
適合相手: エッジカードまたはSpeedMezzリセプタクル  
寸法単位: mm  
RoHS: 準拠  
ハロゲンフリー: 適合

### 電気的性能

最大定格電圧: 250V AC  
最大定格電流: 1.0A (1ピンあたり)  
接触抵抗: 10 mΩ以下  
耐電圧: 300V AC  
絶縁抵抗: 10 MΩ以上

### 機械的性能

耐久挿抜回数:  
メザニン (SpeedStack): 20回以上  
エッジカード (SpeedStack): 5回以上  
耐久挿抜回数:  
メザニン (SpeedEdge): 100回以上  
(目標値)  
エッジカード (SpeedEdge): 20回以上

### 材質

ハウジング: ガラス充填耐熱プラスチック (94-V0)  
コンタクト: 銅 (Cu) 合金  
メッキ:  
コンタクトエリアー 金 (Au) 0.76μm以上  
半田付け部: 錫 (Sn)、0.76 ~ 1.52μm  
下地メッキ: ニッケル (Ni) 1.27μm以上

基板厚: 1.58mm  
使用温度範囲: -40 ~ +105°C

## オーダーインフォメーション

シリーズ番号	SpeedMezzコネクターサブファミリー	コンポーネント	高さ (mm)	極数
171450	SpeedStack	リセプタクル	3.10 ~ 4.10	22、60、82 (2列バイ: 22、60極)
171446		プラグ (差動)	0.90 ~ 3.90	22、60
171810	SpeedField	プラグ、SpeedStackと嵌合	2.90 ~ 3.90	22、60
173300	SpeedEdge	Receptacle	5.6	22、60、82 (2列バイ: 22、60極)
173305	SpeedField	プラグ、SpeedEdgeと嵌合	1.4	22、60

カスタム製品	ディスクリプション
モレックス担当窓口にお問い合わせください。	SpeedCableカスタムケーブルアセンブリー
	SpeedFlexカスタムフレキシアセンブリー

[www.molex.com/link/speedmezz.html](http://www.molex.com/link/speedmezz.html)  
[www.japanese.molex.com/link/speedmezz.html](http://www.japanese.molex.com/link/speedmezz.html)

Molexは、アメリカ合衆国におけるMolex, LLCの登録商標であり、他の国々でも登録されている場合があります。ここに表示されているその他すべての商標も該当する所有者に帰属します。